
南亞電路板股份有限公司 2020年上半年營運概況

2020年8月20日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

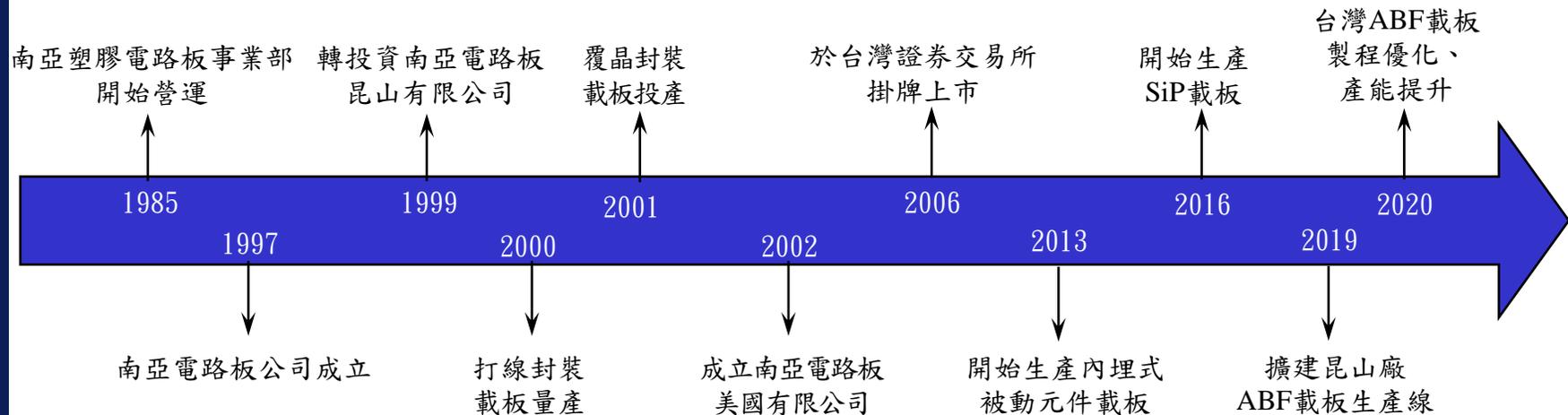
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2020年上半年合併營業額為新台幣 170.2億元。
- 台股上市市值：新台幣512.4億元(2020年6月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2020 : 台灣ABF載板製程優化、產能提升



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)

營業額

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2018年上半年

2019年上半年

2020年上半年

13,164.4

13,889.3

17,020.8

年成長率：+5.5%

年成長率：+22.5%

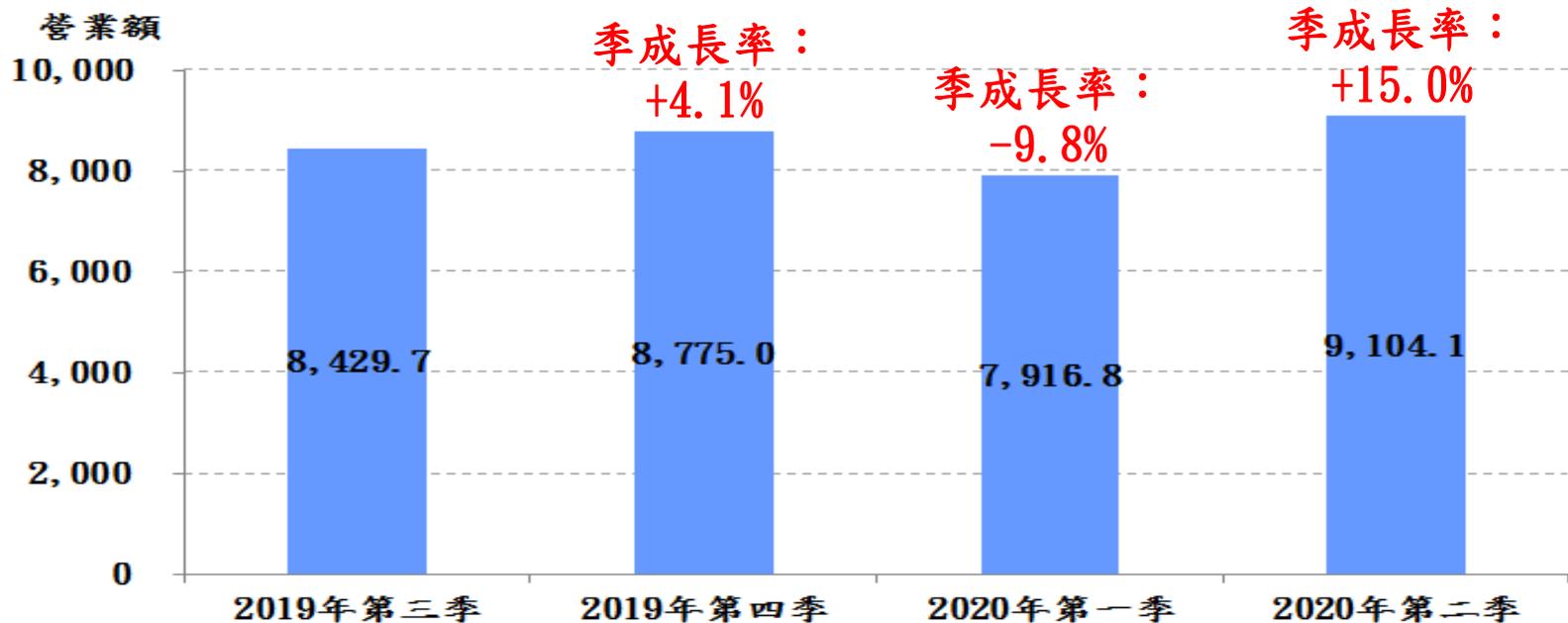
- 2019年上半年營收較2018年同期增加5.5%:
本公司致力於拓展高值化產品市場，提升產品平均售價，故營收比2018年同期成長。
- 2020年上半年營收較2019年同期增加22.5%:
本公司高值化產品比重增加，推升產品平均單價，使營收比2019年同期成長。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)



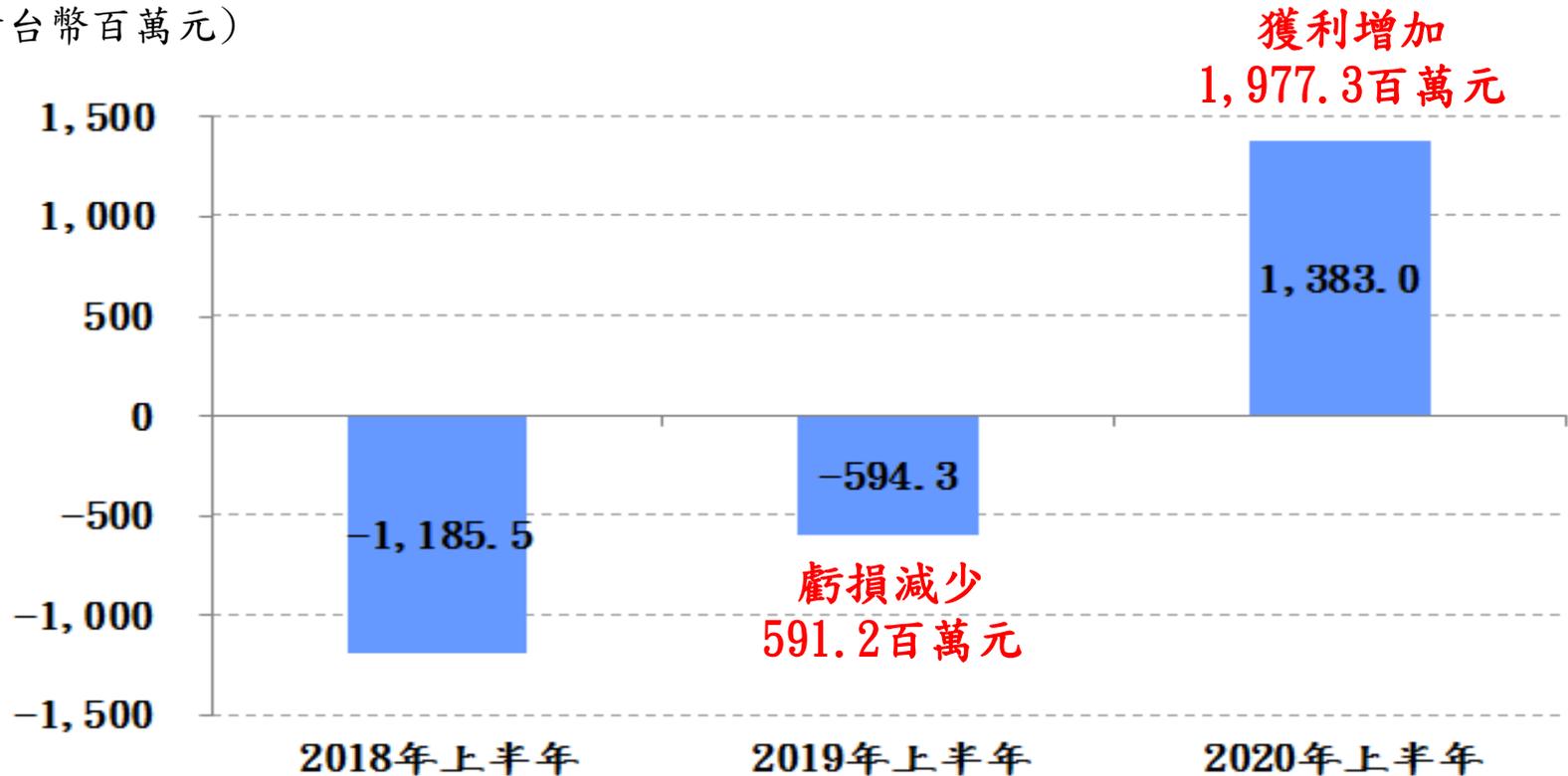
- 2019年第四季營收較第三季增加4.1%:
2019年第四季因ABF載板銷售狀況持續增溫，故第四季營收進一步成長。
- 2020年第一季營收較2019第四季減少9.8%:
2020年第一季因新冠肺炎疫情影響需求，且春節年假生產天數減少影響12%，致營收比2019年第四季減少，但仍比2019年同期增加26.07%。
- 2020年第二季營收較第一季增加15.0%:
2020年第二季因本公司提早佈局5G網通市場的成效顯現，且宅經濟與遠距上班/學習之需求增加，故比第一季成長。



財務狀況

近三年營業利益(虧損)

(新台幣百萬元)



■ 2019年上半年營業虧損較2018年同期減少591.2百萬元:

本公司長期布局高層數大尺寸網通載板，並於2019年上半年導入量產，故高值化產品銷售佔比持續提升，營業虧損比2018年同期減少。

■ 2020年上半年營業利益較2019年同期增加1,977.3百萬元:

本公司持續擴大高階網通與系統級封裝等高值化IC載板產品銷售，並持續優化製程與導入自動化工程，再提升良率與改善生產成本。



財務狀況

近一年每季營業利益(虧損)

(新台幣百萬元)

營業利益

1000

800

600

400

200

0

2019年第三季

2019年第四季

2020年第一季

2020年第二季

200.3

465.3

392.2

990.8

獲利增加
265.0百萬元

獲利減少
73.1百萬元

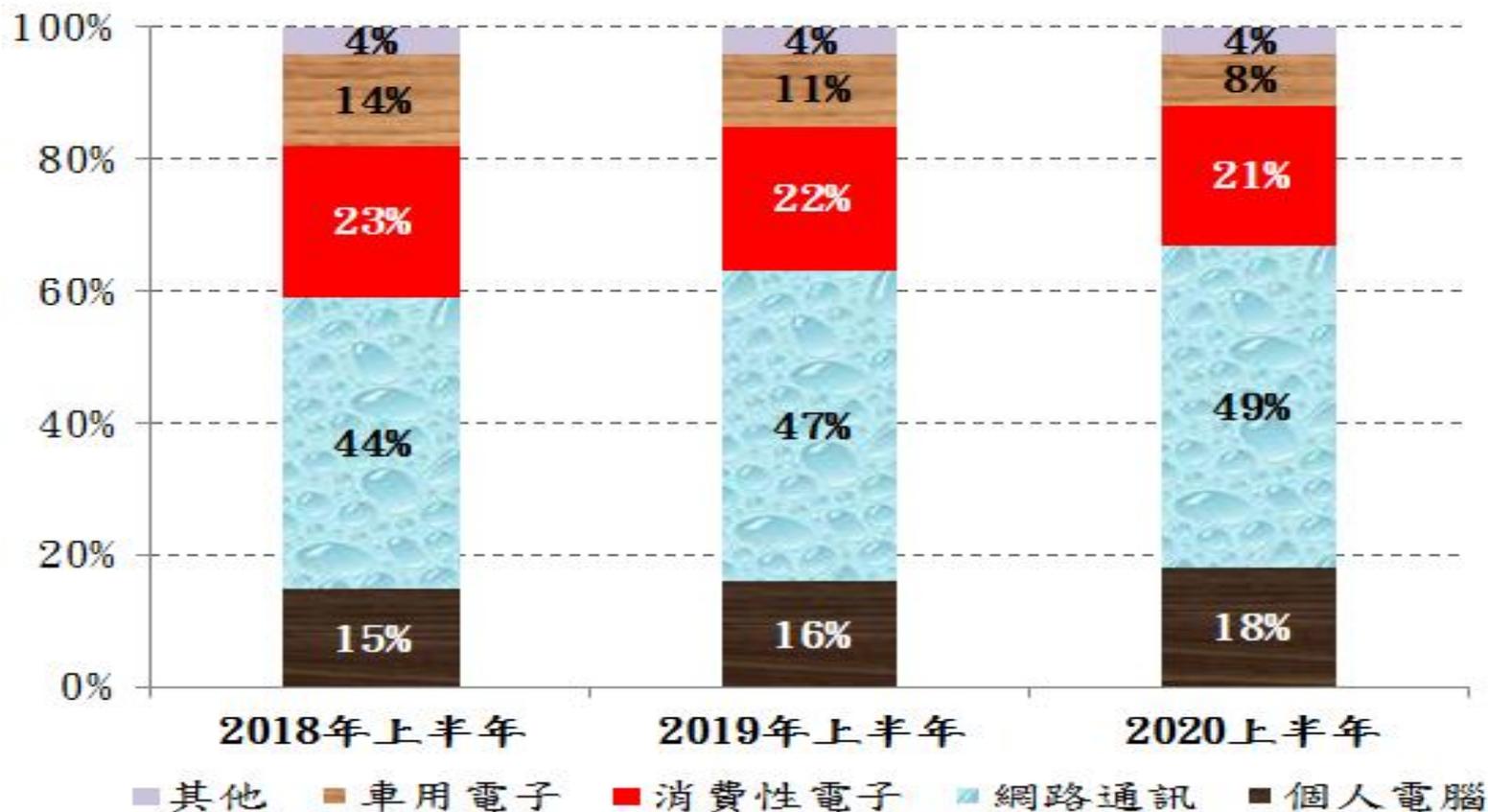
獲利增加
598.6百萬元

- 2019年第四季營業利益較第三季增加265.0百萬元：
因高層數大尺寸網通載板需求續旺，故獲利比第三季提升。
- 2020年第一季營業利益較2019年第四季減少73.1百萬元：
因傳統電子產品淡季影響需求與新冠肺炎防疫支出增加，故獲利比2019年第四季減少。
- 2020年第二季營業利益較第一季增加598.6百萬元：
因網通與系統級封裝等高值化IC載板產品銷售增加，故獲利比第一季提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 本公司受益於處理器客戶市占率提高與提早布局高階網通設備市場，2020年上半年個人電腦與網通產品營收占比提高。
- 受到新冠肺炎疫情影響，消費性電子與汽車需求降低，故本公司2020年上半年消費性電子與車用電路板營收占比略為下滑。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

未來除持續配合客戶，量產高層數大尺寸之5G網通設備、企業級交換器、伺服器、7奈米繪圖晶片與遊戲機處理器等載板外，亦生產人工智慧/高效運算晶片等線路設計複雜、技術層次較高之載板，可有效提升產品平均售價。

■ SiP載板

因應電子產品輕、薄、短、小的發展趨勢，封裝技術發展由IC單一晶片封裝，演變為IC異質晶片封裝，系統級封裝(SiP)載板除應用於真無線藍芽耳機、智慧型手錶等穿戴式裝置外，亦已應用於行動裝置相機模組，SiP載板需求將持續增加。

■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性電子及車用電子等產品設計愈趨精密，高平均單價之高階智慧型手機應用之中介板與HDI使用量持續增加，本公司今年將配合終端市場發展，陸續推出高階筆電與伺服器主機板、固態硬碟及5G手機中介板等產品，以提高獲利。



未來營運目標

持續提高公司獲利

■ 精進製程技術

本公司將持續增加研發專才，精進製程技術，並透過新技術的開發，提高生產良率，簡化生產流程，有效降低生產成本，提高公司獲利。

■ 優化製程導入AI技術

本公司除持續導入自動化生產設備優化製程外，亦將應用人工智慧於生產管理，透過機台自動檢測，使生產自動化演進至智能化，以提高生產良率與效率，並精簡生產人力。

■ 努力提升高值化產品比重

本公司將延續增加高值化產品策略，與美系、陸系客戶共同開發並量產高階网通設備、人工智慧/高效運算、系統級封裝載板、7奈米繪圖晶片及5G手機中介板等產品，並布局5奈米晶片載板市場，使高值化產品比重進一步再提升。

■ 擴建新產能

本公司將確保IC載板新產能依客戶需求時程如期開出，並爭取更多高階產品，以進一步強化產品組合，並擴大IC載板市占率，使公司營收與獲利持續成長。



感謝您的聆聽

